

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 3 区分

【発行日】平成 23 年 9 月 1 日 (2011.9.1)

【公開番号】特開 2009-255271 (P2009-255271A)

【公開日】平成 21 年 11 月 5 日 (2009.11.5)

【年通号数】公開・登録公報 2009-044

【出願番号】特願 2008-199426 (P2008-199426)

【国際特許分類】

B 2 4 B 37/00 (2006.01)

H 0 1 L 21/304 (2006.01)

B 3 2 B 7/02 (2006.01)

B 3 2 B 27/40 (2006.01)

【F I】

B 2 4 B 37/00 M

B 2 4 B 37/00 P

B 2 4 B 37/00 W

H 0 1 L 21/304 6 2 2 F

B 3 2 B 7/02 1 0 1

B 3 2 B 27/40

【手続補正書】

【提出日】平成 23 年 7 月 19 日 (2011.7.19)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

圧縮弾性率が 3 M P a 以上 1 0 M P a 以下の研磨層と、圧縮弾性率が 2 M P a 以上 1 0 M P a 以下のクッション層との積層体からなり、最大厚みと最小厚みの差が 5 0 μ m 以下でかつ、積層体の厚みバラツキをクッション層の厚みで除した値が 0 . 1 5 以下であることを特徴とする研磨パッド。

【請求項 2】

クッション層が無発泡構造である請求項 1 記載の研磨パッド。

【請求項 3】

クッション層がポリウレタンゴムである請求項 1 または 2 記載の研磨パッド。

【請求項 4】

研磨層とクッション層が接着剤で積層されている請求項 1 ~ 3 のいずれかに記載の研磨パッド。

【請求項 5】

半導体基板の研磨用である請求項 1 ~ 4 のいずれかに記載の研磨パッド。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 9

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 9】

上記課題の解決に本発明は以下の構成からなる。

「(1) 圧縮弾性率が 3 MPa 以上 10 MPa 以下の研磨層と、圧縮弾性率が 2 MPa 以上 10 MPa 以下のクッション層との積層体からなり、最大厚みと最小厚みの差が $50\text{ }\mu\text{m}$ 以下でかつ、積層体の厚みバラツキをクッション層の厚みで除した値が 0.15 以下であることを特徴とする研磨パッド。」